

股票代碼：6202

盛群半導體股份有限公司及子公司  
合併財務報告暨會計師核閱報告  
民國一一三年及一一二年第二季

公司地址：新竹科學園區研新二路3號  
電話：(03)563-1999

# 目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~10
(四)重大會計政策之彙總說明	10~12
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	12
(六)重要會計項目之說明	13~29
(七)關係人交易	29~31
(八)質押之資產	31
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	31
(十)重大之災害損失	32
(十一)重大之期後事項	32
(十二)其 他	32
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	32~34
2.轉投資事業相關資訊	34~36
3.大陸投資資訊	37~39
4.主要股東資訊	40
(十四)部門資訊	40



安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955  
傳真 Fax + 886 3 563 2277  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師核閱報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

### 前言

盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年六月三十日之合併資產負債表，與民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

### 範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

### 保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一三年及一一二年六月三十日之資產總額分別為1,117,814千元及577,413千元，分別占合併資產總額之19%及9%；負債總額分別為29,632千元及48,900千元，分別占合併負債總額之1%及2%；民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之綜合損益分別為18,812千元、(35,079)千元、16,359千元及(51,239)千元，其絕對值分別占合併綜合損益之59%、706%、6%及32%。

### 保留結論

依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年六月三十日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併財務績效暨民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併現金流量之情事。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂倩慧



鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1040007866號  
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號  
民國一一三年七月二十九日

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年六月三十日 一十三年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	113.6.30		112.12.31		112.6.30			113.6.30		112.12.31		112.6.30	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>													
<b>流動資產：</b>													
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,074,825	18	831,410	13	1,103,524	17	2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 1,000,000	17	1,000,000	17	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	173,937	3	236,652	4	408,322	7	2150 應付票據	49,873	1	36,068	1	27,514	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	61,484	1	43,959	1	62,375	1	2170 應付帳款	217,825	4	102,118	2	176,197	3
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)及七)	389,247	7	281,008	4	444,535	7	2180 應付帳款—關係人(附註七)	798	-	414	-	229	-
130X 存貨(附註六(五))	1,377,347	23	1,593,148	26	1,911,616	30	2201 應付薪資及獎金	234,439	4	314,949	5	401,259	6
1476 其他金融資產—流動(附註六(六)、七及八)	1,588,439	27	1,280,546	21	492,023	8	2216 應付股利	101,776	2	-	-	913,399	14
1479 其他流動資產—其他	73,095	1	73,920	1	73,716	1	2230 本期所得稅負債	10,345	-	15,553	-	27,012	1
	<u>4,738,374</u>	<u>80</u>	<u>4,340,643</u>	<u>70</u>	<u>4,496,111</u>	<u>71</u>	2280 租賃負債—流動(附註六(十二))	19,690	-	19,472	-	15,849	-
<b>非流動資產：</b>													
1518 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(附註六(三))	8,472	-	679,811	11	610,920	10	2310 預收款項(附註七)	20,915	-	21,279	-	24,755	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七)及七)	516,575	9	490,671	8	419,778	7	2399 其他流動負債—其他	84,690	1	79,357	1	194,092	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	394,614	7	411,557	7	378,470	6		<u>1,740,351</u>	<u>29</u>	<u>1,589,210</u>	<u>26</u>	<u>1,780,306</u>	<u>28</u>
1755 使用權資產(附註六(九))	98,011	1	105,866	2	94,190	1	<b>非流動負債：</b>						
1780 無形資產(附註六(十))	54,011	1	22,994	-	50,409	1	2570 遞延所得稅負債	331,940	6	331,940	6	422,707	7
1840 遞延所得稅資產	66,658	1	78,011	1	158,616	2	2580 租賃負債—非流動(附註六(十二))	81,055	1	88,798	1	80,652	1
1900 其他非流動資產(附註九)	63,487	1	61,386	1	123,039	2	2640 淨確定福利負債—非流動	20,971	-	30,015	-	31,765	1
	<u>1,201,828</u>	<u>20</u>	<u>1,850,296</u>	<u>30</u>	<u>1,835,422</u>	<u>29</u>	2645 存入保證金	51,434	1	51,361	1	22,707	-
<b>資產總計</b>	<u>\$ 5,940,202</u>	<u>100</u>	<u>6,190,939</u>	<u>100</u>	<u>6,331,533</u>	<u>100</u>		<u>485,400</u>	<u>8</u>	<u>502,114</u>	<u>8</u>	<u>557,831</u>	<u>9</u>
							<b>負債總計</b>	<u>2,225,751</u>	<u>37</u>	<u>2,091,324</u>	<u>34</u>	<u>2,338,137</u>	<u>37</u>
							<b>權益(附註六(十五))：</b>						
							歸屬母公司業主之權益：						
							3110 普通股股本	2,261,682	38	2,261,682	36	2,261,682	36
							3200 資本公積	142,309	3	142,309	2	142,309	2
							3300 保留盈餘	1,311,835	22	1,279,893	21	1,260,641	20
							3400 其他權益	(58,293)	(1)	355,914	6	271,673	4
							歸屬母公司業主之權益總計	<u>3,657,533</u>	<u>62</u>	<u>4,039,798</u>	<u>65</u>	<u>3,936,305</u>	<u>62</u>
							36XX 非控制權益	56,918	1	59,817	1	57,091	1
							<b>權益總計</b>	<u>3,714,451</u>	<u>63</u>	<u>4,099,615</u>	<u>66</u>	<u>3,993,396</u>	<u>63</u>
							<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 5,940,202</u>	<u>100</u>	<u>6,190,939</u>	<u>100</u>	<u>6,331,533</u>	<u>100</u>

董事長：吳啟勇



經理人：蔡榮宗



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年四月一日至六月三十日及一十二年及一十一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	113年4月至6月		112年4月至6月		113年1月至6月		112年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 682,586	100	715,722	100	1,126,114	100	1,476,556	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十三)、(十七)、七及十二)	402,420	59	388,360	54	683,903	61	782,800	53
營業毛利	280,166	41	327,362	46	442,211	39	693,756	47
5910 未實現銷貨利益之變動	(1,074)	-	(61,563)	(8)	(37,453)	(3)	(91,819)	(6)
已實現營業毛利	281,240	41	388,925	54	479,664	42	785,575	53
營業費用(附註六(十七)及十二)：								
6100 推銷費用	34,031	5	34,430	5	66,169	6	72,399	5
6200 管理費用	98,601	14	72,699	10	176,500	16	156,402	10
6300 研究發展費用	206,942	30	177,744	25	407,869	36	409,030	28
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	-	-	-	-	(51,880)	(5)	-	-
	339,574	49	284,873	40	598,658	53	637,831	43
營業淨利(損)	(58,334)	(8)	104,052	14	(118,994)	(11)	147,744	10
營業外收入及支出：								
7020 其他利益及損失(附註六(十九)及七)	13,218	2	(12,372)	(1)	40,508	4	5,822	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(七))	6,473	1	(34,566)	(5)	(9,993)	(1)	(57,923)	(4)
7100 利息收入	9,587	1	7,838	1	18,946	2	15,193	1
7510 利息費用	(5,315)	(1)	(338)	-	(11,380)	(1)	(647)	-
	23,963	3	(39,438)	(5)	38,081	4	(37,555)	(3)
稅前淨利(損)	(34,371)	(5)	64,614	9	(80,913)	(7)	110,189	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	100	-	8,902	1	124	-	16,413	1
本期淨利(損)	(34,471)	(5)	55,712	8	(81,037)	(7)	93,776	6
8300 其他綜合損益：								
8310 不重分類至損益之項目								
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(三))	(11,225)	(2)	8,457	1	(246,459)	(22)	116,350	8
8360 後續可能重分類至損益之項目								
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	11,887	2	(52,106)	(7)	41,698	4	(43,853)	(3)
8371 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(七))	5,172	-	(21,376)	(3)	16,601	1	(16,987)	(1)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	3,328	-	(14,280)	(2)	11,356	1	(11,812)	(1)
後續可能重分類至損益之項目合計	13,731	2	(59,202)	(8)	46,943	4	(49,028)	(3)
8300 本期其他綜合損益	2,506	-	(50,745)	(7)	(199,516)	(18)	67,322	5
本期綜合損益總額	\$ (31,965)	(5)	4,967	1	(280,553)	(25)	161,098	11
本期淨利(損)歸屬於：								
8610 母公司業主	\$ (34,161)	(5)	56,134	8	(79,452)	(7)	92,880	6
8620 非控制權益	(310)	-	(422)	-	(1,585)	-	896	-
	\$ (34,471)	(5)	55,712	8	(81,037)	(7)	93,776	6
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主	\$ (32,076)	(5)	7,472	1	(280,489)	(25)	161,981	11
8720 非控制權益	111	-	(2,505)	-	(64)	-	(883)	-
	\$ (31,965)	(5)	4,967	1	(280,553)	(25)	161,098	11
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))								
9750 基本每股盈餘	\$ (0.15)		0.25		(0.35)		0.41	
9850 稀釋每股盈餘	\$ (0.15)		0.25		(0.35)		0.41	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：蔡榮宗



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國一一年及一二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益		合計	歸屬於母 公司業主之 權益總計	非控制 權益	權益總計
	保留盈餘					國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現評價 損益					
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			合計				
民國一一年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	955,160	2,642	1,114,632	2,072,434	(29,710)	232,282	202,572	4,678,997	65,644	4,744,641
本期淨利	-	-	-	-	92,880	92,880	-	-	-	92,880	896	93,776
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(47,249)	116,350	69,101	69,101	(1,779)	67,322
本期綜合損益總額	-	-	-	-	92,880	92,880	(47,249)	116,350	69,101	161,981	(883)	161,098
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	111,462	-	(111,462)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(904,673)	(904,673)	-	-	-	(904,673)	-	(904,673)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,670)	(7,670)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(101)	101	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年六月三十日餘額	\$ 2,261,682	142,309	1,066,622	2,541	191,478	1,260,641	(76,959)	348,632	271,673	3,936,305	57,091	3,993,396
民國一三年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	1,066,622	2,541	210,730	1,279,893	(58,929)	414,843	355,914	4,039,798	59,817	4,099,615
本期淨損	-	-	-	-	(79,452)	(79,452)	-	-	-	(79,452)	(1,585)	(81,037)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	45,422	(246,459)	(201,037)	(201,037)	1,521	(199,516)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(79,452)	(79,452)	45,422	(246,459)	(201,037)	(280,489)	(64)	(280,553)
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	11,223	-	(11,223)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(101,776)	(101,776)	-	-	-	(101,776)	-	(101,776)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	213,170	213,170	-	(213,170)	(213,170)	-	-	-
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,835)	(2,835)
民國一三年六月三十日餘額	\$ 2,261,682	142,309	1,077,845	2,541	231,449	1,311,835	(13,507)	(44,786)	(58,293)	3,657,533	56,918	3,714,451

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：蔡榮宗



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	113年1月至6月	112年1月至6月
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利(損)	\$ (80,913)	110,189
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	35,923	39,319
攤銷費用	45,215	33,658
迴轉存貨跌價	(20,000)	-
預期信用減損損失(迴轉利益)	(51,880)	-
利息費用	11,380	647
利息收入	(18,946)	(15,193)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	9,993	57,923
聯屬公司間未實現銷貨利益之變動	(37,453)	(91,819)
其他不影響現金流量之損費淨額	5,092	3,698
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	62,399	(166,259)
應收票據及帳款(含關係人)	(88,235)	392,433
存貨	242,708	(109,395)
其他營業資產	(864)	(25,209)
應付票據及帳款(含關係人)	115,658	(442,036)
預收款項	(643)	(287)
淨確定福利負債	(9,168)	(16,978)
其他營業負債	(42,132)	(166,526)
營運產生之現金之流入(出)	178,134	(395,835)
收取之利息	17,937	19,273
收取之股利	5,180	6,572
支付之利息	(11,380)	(647)
支付之所得稅	(4,505)	(23,842)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<b>185,366</b>	<b>(394,479)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(9,500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	406,787	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	18,093	18,041
採用權益法之被投資公司減資及清算退還股款	-	3,470
處分不動產、廠房及設備	55	751
取得不動產、廠房及設備	(1,581)	(87,471)
存出保證金增加	(40)	(442)
取得無形資產	(76,213)	(60,595)
其他金融資產(增加)減少	(285,844)	740,072
其他非流動資產增加	(1,587)	(11,770)
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<b>59,670</b>	<b>592,556</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
存入保證金(減少)增加	(48)	200
租賃本金償還	(9,950)	(12,202)
非控制權益變動	(2,835)	(1,096)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(12,833)</b>	<b>(13,098)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,212	(15,433)
本期現金及約當現金增加數	243,415	169,546
期初現金及約當現金餘額	831,410	933,978
期末現金及約當現金餘額	\$ <b>1,074,825</b>	<b>1,103,524</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：蔡榮宗



會計主管：廖明通



**盛群半導體股份有限公司及子公司**  
**合併財務報告附註**  
**民國一一三年及一一二年第二季**  
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

**一、公司沿革**

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

**二、通過財務報告之日期及程序**

本合併財務報告已於民國一一三年七月二十九日經董事會通過發布。

**三、新發布及修訂準則及解釋之適用**

(一)已採用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一一三年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則會計準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第一號之修正「負債分類為流動或非流動」
- 國際會計準則第一號之修正「具合約條款之非流動負債」
- 國際會計準則第七號及國際財務報導準則第七號之修正「供應商融資安排」
- 國際財務報導準則第十六號之修正「售後租回中之租賃負債」

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

合併公司評估適用下列自民國一一四年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則，將不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際會計準則第二十一號之修正「缺乏可兌換性」

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

國際會計準則理事會已發布及修正但尚未經金管會認可之準則及解釋，對合併公司可能攸關者如下：

新發布或修訂準則	主要修訂內容	理事會發布之 生效日
國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」	<p>新準則引入三種類收益及費損、兩項損益表小計及一項關於管理階層績效衡量的單一附註。此等三項修正與強化在財務報表中如何對資訊細分之指引，為使用者提供更佳及更一致的資訊奠定基礎，並將影響所有公司。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更具結構化之損益表：根據現行準則，公司使用不同的格式來表達其經營成果，使投資者難以比較不同公司間的財務績效。新準則採用更具結構化的損益表，引入新定義之「營業利益」小計，並規定所有收益及費損，將依公司主要經營活動歸類於三個新的不同種類。</li> <li>• 管理階層績效衡量(MPM)：新準則引入管理階層績效衡量之定義，並要求公司於財務報表之單一附註中，對於每一衡量指標解釋其為何可提供有用之資訊、如何計算及如何將衡量指標與根據國際財務報導準則會計準則所認列的金額進行調節。</li> <li>• 較細分之資訊：新準則包括公司如何於財務報表強化對資訊分組之指引。此包括資訊是否應列入主要財務報表或於附註中進一步細分之指引。</li> </ul>	2027年1月1日

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

合併公司預期下列其他尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第十號及國際會計準則第二十八號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第十七號「保險合約」及國際財務報導準則第十七號之修正
- 國際財務報導準則第十九號「不具公共課責性之子公司：揭露」

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- 國際財務報導準則第九號及國際財務報導準則第七號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」
- 國際財務報導準則會計準則之年度改善

### 四、重大會計政策之彙總說明

#### (一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一二年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註四。

#### (二) 合併基礎

##### 1. 合併財務報告編製原則

合併財務報告編製原則與民國一一二年度合併財務報告一致，相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註四(三)。

##### 2. 列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			113.6.30	112.12.31	112.6.30
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100 % (註3)	100 % (註3)	100 % (註3)
MCU	Best Health Electronics Corp. (Best Health)	投資控股公司	75 %	75 %	75 %
Best Health	悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
Best Health	Best Health Electronics HK Limited (Best Health HK)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
MCU	Anchip Technology Corporation (Anchip)	投資控股公司	60 %	60 %	60 %

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			113.6.30	112.12.31	112.6.30
Anchip	安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
MCU	Best Driver-tech Corporation (Best Driver-tech)	投資控股公司	80 %	80 %	80 %
Best Driver-tech	芯動微電子(杭州)有限公司(芯動微)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
MCU	Best Module-tech Corporation(Best Module-tech)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
Best Module-tech	易智芯科技(廈門)有限公司(易智芯)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	製造及銷售與技術服務	100 % (註3)	100 % (註3)	100 % (註3)
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	製造及銷售與技術服務	100 % (註3)	100 % (註3)	100 % (註3)
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	製造及銷售與技術服務	100 % (註3)	100 % (註3)	100 % (註3)
本公司及盛凌投資	Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	製造及銷售與技術服務	100 % (註1)	100 % (註1)	100 % (註1)
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售與技術服務	54.75 % (註2)	54.75 % (註2)	54.75 % (註2)
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
Best Solution	優方科技(東莞)有限公司(優方東莞)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
盛凌投資	倍創科技股份有限公司(倍創)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
倍創	Best Modules Corp.(Best Modules)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
Best Modules	倍易創新電子商務(廈門)有限公司(倍易創新)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
盛凌投資	芯通科技股份有限公司(芯通)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %
芯通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	投資控股公司	100 %	100 %	100 %
BestComm	芯通電子科技(東莞)有限公司	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %	100 %

註1：係盛凌投資持有99.9%股權及盛群持有0.1%股權。

註2：係盛凌投資直接持有40%股權及透過關聯企業持有36.875%股權所計算之綜合持股比例。

註3：其財務報告業經台灣母公司會計師核閱，其餘非重要子公司未經核閱。

3.未列入合併財務報告之子公司：無。

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (三)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

### (四)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第三十四號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並全數認列為當期所得稅費用。

所得稅費用直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

### (五)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導日依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

## 五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一二年度合併財務報告附註五一致。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計科目之說明與民國一一二年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註六。

(一)現金及約當現金

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
現金及活期存款	\$ 912,611	505,353	591,091
定期存款	162,214	326,057	512,433
	<u>\$ 1,074,825</u>	<u>831,410</u>	<u>1,103,524</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
受益憑證	\$ <u>173,937</u>	<u>236,652</u>	<u>408,322</u>

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(二十)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

(三)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
未上市(櫃)公司股票			
諧永投資股份有限公司 (諧永投資)	\$ -	599,353	538,822
Unitech Capital Inc. (Unitech)	-	67,053	57,345
精匠微電子股份有限公司 (精匠微電子)	8,311	13,141	14,366
金佶科技股份有限公司 (金佶科技)	161	264	387
	<u>\$ 8,472</u>	<u>679,811</u>	<u>610,920</u>

合併公司持有該等權益工具投資為長期策略性投資且非為交易目的所持有，故已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

合併公司於民國一一三年六月二十七日及五月三十日因營運計畫，故出售指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之諧永投資及Unitech，處分時之公允價值為366,587千元及40,200千元，累計處分(損)益計259,720千元及(46,550)千元，故已將前述累積處分利益自其他權益移轉至保留盈餘。

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(二十)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
應收票據	\$ 29	4,597	783
應收帳款	62,319	45,363	72,164
應收關係人款	<u>392,944</u>	<u>330,902</u>	<u>552,470</u>
	455,292	380,862	625,417
減：備抵損失	<u>(4,561)</u>	<u>(55,895)</u>	<u>(118,507)</u>
	<u>\$ 450,731</u>	<u>324,967</u>	<u>506,910</u>

合併公司針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司應收款項之預期信用損失分析如下：

	<u>113.6.30</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 439,066	0.50%~1.50%	3,871
逾期90天以下	16,150	3.80%	614
逾期90天以上	<u>76</u>	100.00%	<u>76</u>
合計	<u>\$ 455,292</u>		<u>4,561</u>
	<u>112.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 303,874	0.50%~7.00%	20,750
逾期90天以下	57,242	30.03%	17,189
逾期90天以上	<u>12,966</u>	100.00%	<u>12,966</u>
合計	<u>\$ 374,082</u>		<u>50,905</u>

民國一十二年十二月三十一日因個別客戶應收帳款6,780千元經評估有違約風險，故針對該客戶提列4,990千元預期信用損失。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	<b>112.6.30</b>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 488,736	0.50%~5.50%	25,344
逾期90天以下	58,859	26.06%	15,341
逾期90天以上	<u>77,822</u>	100.00%	<u>77,822</u>
合計	<u>\$ 625,417</u>		<u>118,507</u>

合併公司應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	<b>113年 1月至6月</b>	<b>112年 1月至6月</b>
期初餘額	\$ 55,895	120,747
提列(迴轉)之減損損失	(51,880)	-
匯率變動之影響數	<u>546</u>	<u>(2,240)</u>
期末餘額	<u>\$ 4,561</u>	<u>118,507</u>

上列應收票據及帳款未有提供作質押擔保之情形。

(五)存貨

	<b>113.6.30</b>	<b>112.12.31</b>	<b>112.6.30</b>
原料及物料	\$ 845,761	1,101,841	1,062,484
在製品	337,491	357,622	487,806
製成品及商品	<u>194,095</u>	<u>133,685</u>	<u>361,326</u>
	<u>\$ 1,377,347</u>	<u>1,593,148</u>	<u>1,911,616</u>

營業成本組成明細如下：

	<b>113年 4月至6月</b>	<b>112年 4月至6月</b>	<b>113年 1月至6月</b>	<b>112年 1月至6月</b>
銷貨成本	\$ 420,813	386,428	700,000	779,010
存貨跌價回升利益	(20,000)	-	(20,000)	-
報廢成本	<u>1,607</u>	<u>1,932</u>	<u>3,903</u>	<u>3,790</u>
	<u>\$ 402,420</u>	<u>388,360</u>	<u>683,903</u>	<u>782,800</u>

上述合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(六)其他金融資產－流動

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 1,555,120	1,259,611	462,577
受限制銀行存款	9,035	9,024	8,924
其他	<u>24,284</u>	<u>11,911</u>	<u>20,522</u>
	<u>\$ 1,588,439</u>	<u>1,280,546</u>	<u>492,023</u>

合併公司於民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(二十)。

(七)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 602,714	614,263	660,249
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(86,139)</u>	<u>(123,592)</u>	<u>(240,471)</u>
	<u>\$ 516,575</u>	<u>490,671</u>	<u>419,778</u>

合併公司採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，其彙總財務資訊如下，該等財務資訊係於合併公司之合併財務報告中所包含之金額：

	<u>113年 4月至6月</u>	<u>112年 4月至6月</u>	<u>113年 1月至6月</u>	<u>112年 1月至6月</u>
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之金額：				
本期淨利(損)	\$ 6,473	(34,566)	(9,993)	(57,923)
其他綜合損益	<u>5,172</u>	<u>(21,376)</u>	<u>16,601</u>	<u>(16,987)</u>
綜合損益總額	<u>\$ 11,645</u>	<u>(55,942)</u>	<u>6,608</u>	<u>(74,910)</u>

Bestway於民國一一二年五月清算完結並退回股款3,470千元。

合併公司於民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日獲配關聯企業之現金股利分別為5,180千元及6,572千元。

上述合併公司之採用權益法之投資均未有提供作質押擔保之情形。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(八)不動產、廠房及設備

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國113年1月1日餘額	\$ 26,676	625,069	366,072	126,692	1,144,509
本期增添	-	664	49	868	1,581
本期減少	-	-	(11,648)	(12,884)	(24,532)
匯率變動之影響	-	9,704	3,620	2,216	15,540
民國113年6月30日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>635,437</u>	<u>358,093</u>	<u>116,892</u>	<u>1,137,098</u>
民國112年1月1日餘額	\$ 26,676	523,653	393,425	113,260	1,057,014
本期增添	-	80,659	3,521	3,291	87,471
本期減少	-	-	(342)	(1,891)	(2,233)
匯率變動之影響	-	(9,661)	(4,170)	(1,718)	(15,549)
民國112年6月30日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>594,651</u>	<u>392,434</u>	<u>112,942</u>	<u>1,126,703</u>
累計折舊：					
民國113年1月1日餘額	\$ -	324,026	314,861	94,065	732,952
本期折舊	-	9,214	11,616	4,812	25,642
本期減少	-	-	(10,712)	(12,390)	(23,102)
匯率變動之影響	-	2,720	2,805	1,467	6,992
民國113年6月30日餘額	<u>\$ -</u>	<u>335,960</u>	<u>318,570</u>	<u>87,954</u>	<u>742,484</u>
民國112年1月1日餘額	\$ -	315,875	318,604	96,292	730,771
本期折舊	-	7,539	16,343	3,242	27,124
本期減少	-	-	(338)	(1,838)	(2,176)
匯率變動之影響	-	(2,765)	(3,293)	(1,428)	(7,486)
民國112年6月30日餘額	<u>\$ -</u>	<u>320,649</u>	<u>331,316</u>	<u>96,268</u>	<u>748,233</u>
帳面價值：					
民國113年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>301,043</u>	<u>51,211</u>	<u>32,627</u>	<u>411,557</u>
民國113年6月30日	<u>\$ 26,676</u>	<u>299,477</u>	<u>39,523</u>	<u>28,938</u>	<u>394,614</u>
民國112年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>207,778</u>	<u>74,821</u>	<u>16,968</u>	<u>326,243</u>
民國112年6月30日	<u>\$ 26,676</u>	<u>274,002</u>	<u>61,118</u>	<u>16,674</u>	<u>378,470</u>

上述合併公司不動產、廠房及設備均未有提供作質押擔保之情形。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(九)使用權資產

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>總 計</u>
帳面價值：			
民國113年1月1日	\$ <u>52,277</u>	<u>53,589</u>	<u>105,866</u>
民國113年6月30日	\$ <u>50,740</u>	<u>47,271</u>	<u>98,011</u>
民國112年1月1日	\$ <u>55,352</u>	<u>30,450</u>	<u>85,802</u>
民國112年6月30日	\$ <u>53,815</u>	<u>40,375</u>	<u>94,190</u>

合併公司使用權資產於民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日間均無重大增添或處分之情形，本期折舊金額請詳附註十二，其他相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註六(九)。

(十)無形資產

	<u>電腦軟體</u>	<u>專利權</u>	<u>總 計</u>
帳面價值：			
民國113年1月1日	\$ <u>22,482</u>	<u>512</u>	<u>22,994</u>
民國113年6月30日	\$ <u>54,011</u>	<u>-</u>	<u>54,011</u>
民國112年1月1日	\$ <u>16,837</u>	<u>6,661</u>	<u>23,498</u>
民國112年6月30日	\$ <u>46,822</u>	<u>3,587</u>	<u>50,409</u>

合併公司無形資產於民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日間均無重大增添或處分之情形，本期攤銷金額請詳附註十二，其他相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註六(十)。

上述合併公司之無形資產均未有提供作質押擔保之情形。

(十一)短期借款

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
無擔保銀行借款	\$ <u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>
尚未使用額度	\$ <u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>154,700</u>
期末借款利率	<u>1.98%~2.06%</u>	<u>1.85%~1.93%</u>	<u>-</u>

上述合併公司之借款均未有提供作質押擔保之情形。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十二)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	113.6.30	112.12.31	112.6.30
流動	\$ <u>19,690</u>	<u>19,472</u>	<u>15,849</u>
非流動	\$ <u>81,055</u>	<u>88,798</u>	<u>80,652</u>

到期分析請詳附註六(二十)。

認列於損益之金額如下：

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
租賃負債之利息費用	\$ <u>358</u>	<u>338</u>	<u>726</u>	<u>647</u>
短期租賃之費用	\$ <u>2,273</u>	<u>2,079</u>	<u>4,395</u>	<u>4,317</u>
低價值租賃資產之費用(不 包含短期租賃之低價值 租賃)	\$ <u>129</u>	<u>156</u>	<u>254</u>	<u>317</u>

租賃認列於現金流量表之金額如下：

	113年 1月至6月	112年 1月至6月
租賃之現金流出總額	\$ <u>15,325</u>	<u>17,483</u>

合併公司承租土地、房屋及建築作為辦公處所，土地之租賃期間通常為二十年，辦公處所之租賃期間通常為二至二十年，部份租賃包含在租賃期間屆滿時得延長與原合約相同期間之選擇權。

部分土地及辦公室之租賃合約包含租賃延長之選擇權，該等合約係由各地區分別管理，因此所約定之個別條款及條件於公司內部有所不同。該等選擇權僅合併公司具有可執行之權利，出租人並無此權利。在無法合理確定將行使可選擇之延長租賃期間之情況下，與選擇權所涵蓋期間之相關給付並不計入租賃負債。

另，科學園區管理局土地合約之租賃給付取決於當地公告地價，並加計各園區再投入之公共設施建設費經攤算後辦理調整。

(十三)員工福利

因前一財務年度報導日後未發生重大市場波動及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一一二年及一一一年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間確定福利計畫之退休金成本。

合併公司之退休金費用，請參閱附註十二之說明。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十四)所得稅

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量。

合併公司之所得稅費用明細如下：

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
當期所得稅費用				
當期產生	\$ <u>100</u>	<u>8,902</u>	<u>124</u>	<u>16,413</u>

合併公司認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
後續可能重分類至損益之項目：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 2,378	(10,422)	8,340	(8,771)
採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>950</u>	<u>(3,858)</u>	<u>3,016</u>	<u>(3,041)</u>
	\$ <u>3,328</u>	<u>(14,280)</u>	<u>11,356</u>	<u>(11,812)</u>

本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一一〇年度。

(十五)資本及其他權益

除下列所述外，合併公司於民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日間資本及其他權益無重大變動，相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註六(十五)。

保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司民國一一二年度及一一一年度盈餘分派案，分別於民國一一三年五月二十九日及一一二年五月二十四日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	112年度		111年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 0.4500	101,776	4.0000	904,673

上述相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢。

(十六)每股盈餘

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
基本每股盈餘：				
歸屬於本公司股東之本期淨利(損)	\$ (34,161)	56,134	(79,452)	92,880
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168	226,168	226,168
基本每股盈餘(元)	\$ (0.15)	0.25	(0.35)	0.41
稀釋每股盈餘：				
歸屬於本公司股東之本期淨利(損)	\$ (34,161)	56,134	(79,452)	92,880
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)：				
員工酬勞	-	184	-	554
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,352	226,168	226,722
稀釋每股盈餘(元)	\$ (0.15)	0.25	(0.35)	0.41

本公司民國一一三年上半年度營運結果為虧損，並未有具稀釋作用之潛在普通股。

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (十七)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日員工酬勞估列金額分別為0千元、7,321千元、0千元及12,573千元，董事酬勞估列金額分別為0千元、872千元、0千元及1,497千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為8,504千元及1,012千元，與本公司董事會擬議內容並無差異，民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為160,430千元及19,099千元，皆係以現金發放，與實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

### (十八)客戶合約之收入

#### 1.收入之細分

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
主要地區市場				
中國大陸	\$ 488,194	473,853	799,840	913,029
臺灣	76,434	92,890	130,458	191,412
其他國家	<u>117,958</u>	<u>148,979</u>	<u>195,816</u>	<u>372,115</u>
	<u>\$ 682,586</u>	<u>715,722</u>	<u>1,126,114</u>	<u>1,476,556</u>
主要產品				
積體電路銷售	\$ 679,464	712,985	1,119,942	1,471,300
設計及燒錄收入	<u>3,122</u>	<u>2,737</u>	<u>6,172</u>	<u>5,256</u>
	<u>\$ 682,586</u>	<u>715,722</u>	<u>1,126,114</u>	<u>1,476,556</u>

#### 2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(四)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十九)營業外收入及支出

合併公司綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
外幣兌換淨利益(損失)	\$ 3,768	(18,873)	18,543	(13,004)
其他	<u>9,450</u>	<u>6,501</u>	<u>21,965</u>	<u>18,826</u>
	<u>\$ 13,218</u>	<u>(12,372)</u>	<u>40,508</u>	<u>5,822</u>

(二十)金融工具

除下列所述外，合併公司金融工具之公允價值及因金融工具而暴露於信用風險、流動性風險及市場風險之情形無重大變動，相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註六(二十)。

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一一三年六月三十日及一一二年十二月三十一日與六月三十日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為232,281千元、186,894千元及308,191千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(3)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(四)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(六)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(合併公司如何判定信用風險低之說明請詳民國一一二年度合併財務報告附註四(七))。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.流動性風險

金融負債之合約到期日分析如下：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
<b>113年6月30日</b>				
非衍生金融負債				
短期借款	\$ 1,000,000	1,010,249	1,010,249	-
應付票據及帳款(含關係人)	268,496	268,496	268,496	-
應付薪資及獎金	234,439	234,439	234,439	-
應付費用(帳列其他流動負債)	46,492	46,492	46,492	-
應付股利	101,776	101,776	101,776	-
存入保證金	51,434	51,434	-	51,434
租賃負債(流動及非流動)	100,745	109,413	20,954	88,459
	<u>\$ 1,803,382</u>	<u>1,822,299</u>	<u>1,682,406</u>	<u>139,893</u>
<b>112年12月31日</b>				
非衍生金融負債				
短期借款	\$ 1,000,000	1,013,504	1,013,504	-
應付票據及帳款(含關係人)	138,600	138,600	138,600	-
應付薪資及獎金	314,949	314,949	314,949	-
應付費用(帳列其他流動負債)	39,817	39,817	39,817	-
存入保證金	51,361	51,361	-	51,361
租賃負債(流動及非流動)	108,270	117,604	20,843	96,761
	<u>\$ 1,652,997</u>	<u>1,675,835</u>	<u>1,527,713</u>	<u>148,122</u>
<b>112年6月30日</b>				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 203,940	203,940	203,940	-
應付薪資及獎金	401,259	401,259	401,259	-
應付費用(帳列其他流動負債)	65,020	65,020	65,020	-
應付股利	913,399	913,399	913,399	-
存入保證金	22,707	22,707	-	22,707
租賃負債(流動及非流動)	96,501	106,096	17,072	89,024
	<u>\$ 1,702,826</u>	<u>1,712,421</u>	<u>1,600,690</u>	<u>111,731</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.市場風險—匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	113.6.30			112.12.31			112.6.30		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>									
<u>貨幣性項目</u>									
美金	\$ 12,764	32.4	413,543	10,617	30.665	325,466	13,226	31.09	411,182
人民幣	60,296	4.4208	266,558	44,834	4.2998	192,779	43,527	4.2584	185,355
<u>非貨幣性項目</u>									
美金	\$ 14,598	32.4	472,972	15,792	30.665	484,095	16,681	31.09	518,615
<u>金融負債</u>									
<u>貨幣性項目</u>									
美金	\$ 3,188	32.4	103,279	1,672	30.665	51,240	3,805	31.09	118,285
人民幣	1,603	4.4208	7,086	1,508	4.2998	6,486	3,185	4.2584	13,563

(2)敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一三年及一一二年六月三十日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之稅後淨利將分別增加或減少4,558千元及3,718千元。

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日外幣兌換淨利益(含已實現及未實現)分別為3,768千元、(18,873)千元、18,543千元及(13,004)千元。

(4)其他價格風險

如報導日金融資產—價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)稅後損益之影響如下：

<u>報導日公允價值</u>	<u>113年1月至6月</u>		<u>112年1月至6月</u>	
	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>
上漲1%	\$ <u>68</u>	<u>1,391</u>	<u>4,887</u>	<u>3,267</u>
下跌1%	\$ <u>(68)</u>	<u>(1,391)</u>	<u>(4,887)</u>	<u>(3,267)</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊,但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值及租賃負債,依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下:

		113.6.30			
		公 允 價 值			
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 173,937	173,937	-	-	173,937
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	8,472	-	-	8,472	8,472
	<u>\$ 182,409</u>	<u>173,937</u>	<u>-</u>	<u>8,472</u>	<u>182,409</u>
		112.12.31			
		公 允 價 值			
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 236,652	236,652	-	-	236,652
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	679,811	-	-	679,811	679,811
	<u>\$ 916,463</u>	<u>236,652</u>	<u>-</u>	<u>679,811</u>	<u>916,463</u>
		112.6.30			
		公 允 價 值			
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 408,322	408,322	-	-	408,322
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	610,920	-	-	610,920	610,920
	<u>\$ 1,019,242</u>	<u>408,322</u>	<u>-</u>	<u>610,920</u>	<u>1,019,242</u>

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

A.合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

B.合併公司持有之金融工具屬無活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

- 無公開報價之權益工具：屬投資公司者，係使用淨資產價值法估算公允價值，資產法係經由評估評價標的涵蓋之個別資產及個別負債之總價值，以反映企業整體價值。其他投資標的，則係使用市場可比公司法估算公允價值，按同業之股價淨值比評估。

(3)民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日間並無任何公允價值等級移轉情形。

### (4)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－權益證券投資。

合併公司歸類為第三等級之無活絡市場權益工具投資具有複數重大不可觀察輸入值。無活絡市場之權益工具投資之重大不可觀察輸入值因彼此獨立，故不存在相互關聯性。

重大不可觀察輸入值之量化資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－無活絡市場之權益工具投資	市場法(可類比上市櫃公司同業股價淨值比)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股價淨值比乘數(113.6.30、112.12.31及112.6.30分別為1.58%~1.7%、1.32%~1.42%及1.29%~1.38%))</li> <li>• 缺乏市場流通性折價(113.6.30、112.12.31及112.6.30皆為25%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股價淨值比乘數愈高，公允價值愈高</li> <li>• 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低</li> </ul>
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－無活絡市場之權益工具投資	淨資產價值法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 淨資產價值</li> <li>• 缺乏市場流通性折價(112.12.31及112.6.30分別為10%及10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不適用</li> <li>• 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低</li> </ul>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)第三等級間之變動明細

	透過其他綜合損益按公允價值衡量— 無公開報價之權益工具	
	113年1月至6月	112年1月至6月
1月1日餘額	\$ 679,811	503,111
新增	-	9,500
處分	(406,787)	-
減資退回股款	(18,093)	(18,041)
認列於其他綜合損益	(246,459)	116,350
6月30日餘額	<u>\$ 8,472</u>	<u>610,920</u>

上述總損益，係列報於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益」。其中與民國一一三年及一一二年六月三十日仍持有之資產相關者如下：

	113年 1月至6月	112年 1月至6月
總損益		
認列於其他綜合損益（列報於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益」）	\$ (4,933)	116,350

(廿一)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一二年度合併財務報告附註六(廿一)所揭露者並無重大變動。

(廿二)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一二年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一二年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一二年度合併財務報告附註六(廿二)。

(廿三)非現金交易之籌資活動

合併公司非現金交易籌資活動如下：

- 1.以租賃方式取得使用權資產，請詳附註六(九)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.來自籌資活動之負債之調節如下表：

	<u>113.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>其他</u>	<u>113.6.30</u>
租賃負債(流動及非流動)	\$ 108,270	(9,950)	2,425	100,745
存入保證金	51,361	(48)	121	51,434
短期借款	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,000,000</u>
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 1,159,631</u>	<u>(9,998)</u>	<u>2,546</u>	<u>1,152,179</u>
	<u>112.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>其他</u>	<u>112.6.30</u>
租賃負債(流動及非流動)	\$ 88,121	(12,202)	20,582 (註)	96,501
存入保證金	<u>22,696</u>	<u>200</u>	<u>(189)</u>	<u>22,707</u>
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 110,817</u>	<u>(12,002)</u>	<u>20,393</u>	<u>119,208</u>

註：係合併公司因營運所需於民國一一二年上半年度承租辦公室及廠房所致。

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本合併財務報告之涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下：

<u>關係人名稱</u>	<u>與合併公司之關係</u>
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	合併公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	合併公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	合併公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	合併公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	合併公司之關聯企業
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	合併公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	合併公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	合併公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	合併公司之關聯企業
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	合併公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	合併公司之關聯企業
宏達科技有限公司(宏達)	合併公司之關聯企業
鈺威科技股份有限公司(鈺威)	合併公司之關聯企業，惟盛凌投資已於民國一一二年七月出售鈺威股權
Bestway Electronics Ltd.(Bestway)	合併公司之關聯企業，惟該公司於民國一一二年五月清算完結

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	<u>113年</u> <u>4月至6月</u>	<u>112年</u> <u>4月至6月</u>	<u>113年</u> <u>1月至6月</u>	<u>112年</u> <u>1月至6月</u>
欣宏	\$ 103,380	152,567	173,267	366,079
Crown Rich	74,284	102,805	132,851	165,180
關聯企業	<u>281,817</u>	<u>197,742</u>	<u>452,165</u>	<u>368,239</u>
	<u>\$ 459,481</u>	<u>453,114</u>	<u>758,283</u>	<u>899,498</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一一三年六月三十日及一一二年十二月三十一日與六月三十日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為86,139千元、123,592千元、240,471千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項(含備抵損失)明細如下：

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
欣宏	\$ 78,173	89,411	161,574
Crown Rich	63,476	26,935	78,773
Truetek	45,495	25,482	43,176
New Wave	45,137	14,697	25,050
ForIC	42,581	55,474	67,844
Quanding	37,947	42,009	25,256
關聯企業	<u>76,438</u>	<u>27,000</u>	<u>42,862</u>
	<u>\$ 389,247</u>	<u>281,008</u>	<u>444,535</u>

本公司因上述銷貨交易產生之關係人預收款項明細如下：

	<u>113.6.30</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.6.30</u>
預收款—關聯企業(帳列預收款項)	<u>\$ 8,597</u>	<u>11,521</u>	<u>-</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.進貨

合併公司向關係人進貨金額如下：

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
關聯企業	\$ <u>753</u>	<u>340</u>	<u>1,775</u>	<u>809</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

合併公司因上述交易產生之應付關係人款項明細如下：

	113.6.30	112.12.31	112.6.30
關聯企業	\$ <u>798</u>	<u>414</u>	<u>229</u>

3.其他交易

民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一一三年及一一二年一月一日至六月三十日合併公司向關聯企業收取人力支援等服務性質之收入分別為138千元、541千元、297千元及1,340千元。合併公司因前述交易及代墊等所產生之應收款項餘額，於民國一一三年六月三十日及一一二年十二月三十一日與六月三十日分別為332千元、333千元及835千元，帳列其他金融資產—流動項下。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	113年 4月至6月	112年 4月至6月	113年 1月至6月	112年 1月至6月
短期員工福利	\$ 5,981	6,741	14,486	16,125
退職後福利	108	108	216	216
	\$ <u>6,089</u>	<u>6,849</u>	<u>14,702</u>	<u>16,341</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	113.6.30	112.12.31	112.6.30
定期存款(帳列其他 金融資產—流動)	海關及管理局 等之擔保	\$ <u>9,035</u>	<u>9,024</u>	<u>8,924</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)合併公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

(二)合併公司與一供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金(帳列其他非流動資產項下)，約定合併公司需購買之相關年限及最低數量。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	113年4月至6月			112年4月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	7,282	192,564	199,846	7,266	143,421	150,687
勞健保費用	721	14,086	14,807	719	14,422	15,141
退休金費用	449	17,915	18,364	453	17,659	18,112
其他員工福利費用	404	5,267	5,671	349	4,861	5,210
折舊費用	258	17,510	17,768	395	19,145	19,540
攤銷費用	-	22,421	22,421	-	17,268	17,268

功 能 別 性 質 別	113年1月至6月			112年1月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	14,714	367,508	382,222	14,588	334,081	348,669
勞健保費用	1,435	29,516	30,951	1,441	30,725	32,166
退休金費用	898	35,659	36,557	907	39,969	40,876
其他員工福利費用	779	10,891	11,670	678	9,383	10,061
折舊費用	526	35,397	35,923	869	38,450	39,319
攤銷費用	-	45,215	45,215	-	33,658	33,658

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一三年一月一日至六月三十日合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：無。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係										
0	盛群半導體股份有限公司	芯群集成電路(廈門)有限公司	本公司之子公司	731,507	113,400	113,400	-	-	3.10 %	1,828,767	Y	N	Y

註1：依據本公司背書保證作業程序規定：背書保證之額度。

註2：本公司對外背書保證總額以本公司淨值的百分之五十為限，對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司淨值的百分之二十為限。

3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	8,077	127,974	-	127,974	
本公司	統一強棒貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,663	45,963	-	45,963	
盛凌投資股份有限公司	金佶科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資-非流動	127	161	1.35 %	161	
盛凌投資股份有限公司	精匠微電子股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資-非流動	1,393	8,311	19.48 %	8,311	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額(註3)	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	芯群	本公司之子公司	銷貨	259,635	30 %	月結120天	尚無顯著不同	詳附註七	183,787	57 %	註1
本公司	合泰	本公司之子公司	銷貨	171,152	20 %	月結120天	尚無顯著不同	詳附註七	23,385	7 %	註1

註1：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中消除。

註2：僅就認列收益及資產之公司作單向表達。

註3：應收票據及帳款餘額含備抵損失。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	芯群	子公司	186,335	3.68	-	即期收款	31,294 (註)	2,548

註1：係截至民國一一三年七月十五日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9. 從事衍生性商品交易：無。

10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			佔合併總營業收入或總資產之比率
				科目	金額	交易條件	
0	本公司	合泰	母公司對子公司	銷貨收入	171,152	月結120天	15 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	銷貨收入	259,635	月結120天	23 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	應收帳款	183,787	月結120天	3 %
0	本公司	金科	母公司對子公司	銷貨收入	10,974	月結120天	1 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	7,069	月結60天	1 %
1	合泰	優方	子公司對子公司	銷貨收入	8,231	月結60天	1 %
1	合泰	Anchip	子公司對子公司	銷貨收入	22,400	月結60天	2 %
1	金科	芯群	子公司對子公司	銷貨收入	26,846	月結60天	3 %
1	金科	芯群	子公司對子公司	應收帳款	30,224	月結60天	1 %

註1：僅揭露銷貨及應收帳款佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易，其相對之進貨及應付款項不再贅述。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：應收帳款及票據餘額含備抵損失。

(二) 轉投資事業相關資訊：

合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	627,731	665,449	20,803	100.00 %	1,187,378	(1,268)	(1,268)	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	126,179	(33,187)	(33,187)	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	20,137	(570)	(570)	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	20,137	(570)	(570)	註1、2 本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	976,776	13,502	13,502	註2 本公司之子公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	9,733	9,733	300	40.00 %	18,658	(14,964)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	52,040	(5,111)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	31,124	31,124	1,045	40.00 %	59,118	16,031	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,758	3,758	180	40.00 %	47,271	9,801	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	24,784	24,784	800	40.00 %	71,008	547	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	8,105	8,105	1,501	40.61 %	66,361	(10,545)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	2,641	2,641	80	40.00 %	132,125	(938)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	7,039	7,039	1	40.00 %	519	1,934	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	2,937	2,937	1	60.00 %	39,210	1,036	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	11,677	(12,863)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	滋達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	5,958	(3,847)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項投資	6,405	6,405	1	40.00 %	8,237	118	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	19,808	19,808	5	75.00 %	49,498	1,517	註1、2	本公司之孫公司
Best Health Electronics Corporation	Best Health Electronics HK Limited	香港	電子元器件與單片機芯片的技術支持與諮詢服務	1,299	1,299	300	100.00 %	8,764	1,686	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Best Driver-tech Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,753	6,753	2	80.00 %	10,405	(4,463)	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Module-tech Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	12,426	12,426	3	100.00 %	13,584	(180)	註1、2	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元件及單片機晶片之技術支持與諮詢服務業務	3	3	6	0.10 %	4	508	註2	1 本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	429,826	42,983	100.00 %	670,834	(5,990)	註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,941	95,941	7,880	40.00 %	133,549	(7,832)	註1、2	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	9,516	(3,283)	註1、2	本公司之孫公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	10,322	(3,283)	註1、2	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,140	6,140	200	100.00 %	21,656	(319)	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	天宇微機電股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	(981)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	芯通科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、國際貿易業及資訊軟體服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	27,705	1,858	註1、2	本公司之孫公司
芯通科技股份有限公司	Bestcomm RF Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	14,054	14,054	30	100.00 %	13,969	114	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	倍創科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發、無店面零售業、國際貿易業	105,000	105,000	10,500	100.00 %	90,904	(2,693)	註1、2	本公司之孫公司
倍創科技股份有限公司	Best Modules Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	28,326	28,326	7	100.00 %	32,388	(108)	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元件及單片機晶片之技術支持與諮詢服務業務	2,945	2,945	6,479	99.90 %	3,926	508	註1、2	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	322,726	(註1)	290,645	-	-	290,645	(533)	100 %	(533)	324,665	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路及電子元器件及單片機芯片的批發與進出口業務並提供技術諮詢服務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	(612)	100 %	(612)	820,829	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術支持與諮詢服務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	6,843	40 %	2,737	21,838	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	505	40 %	202	70,782	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(12,375)	40 %	(4,950)	(9,769)	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(1,485)	40 %	(594)	4,512	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	65,860	(註1)	2,647	-	-	2,647	(12,694)	40.61 %	(5,155)	37,365	-
信霖微智電子(上海)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	(5,208)	40 %	(2,083)	15,688	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	18,446	(註1)	1,964	-	-	1,964	(860)	40 %	(344)	131,233	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術支持與諮詢服務業務	21,670	(註1)	1,600	-	-	1,600	16,129	40 %	6,452	38,595	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	(33,189)	100 %	(33,189)	126,136	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	1,923	40 %	769	(355)	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	1,040	60 %	624	38,540	-
集芯源電子科技(深圳)有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	11,974	(註1)	-	-	-	-	118	40 %	47	8,052	-
悠健電子(東莞)有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(133)	75 %	(100)	42,063	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	13,634	(註1)	9,392	-	-	9,392	115	100 %	115	13,236	-
優方科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	4,285	(註1)	-	-	-	-	(299)	54.75 %	(163)	11,088	-
芯動微電子(杭州)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術開發、技術服務及銷售	6,361	(註1)	-	-	-	-	(4,438)	80.00 %	(3,551)	8,612	-
易智芯科技(廈門)有限公司	設計、開發、生產集成電路、電子元器件及單片機芯片及其所需的組件及軟件產品，並提供相關技術諮詢及售後服務	10,573	(註1)	-	-	-	-	(158)	100.00%	(158)	11,302	-
倍易創新電子商務(廈門)有限公司	從事互聯網銷售、集成電路、電子元器件、單片機芯片及其所需的組件及軟件產品的技術開發、技術服務及銷售	28,307	(註1)	28,307	-	-	28,307	(109)	100.00%	(109)	32,357	-

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### 2.轉投資大陸地區限額：

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額(註4)
盛群	655,369 (美金21,751千元)	867,839 (美金26,785千元)	2,194,520
倍創	28,307 (美金962千元)	31,175 (美金962千元)	80,000
芯通	9,392 (美金314千元)	14,754 (美金455千元)	80,000
優方	-	註3	80,000

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；盛群經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計703,408千元(美金21,710千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計164,432千元(美金5,075千元)；倍創經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計31,175千元(美金962千元)；芯通經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計10,157千元(美金314千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計4,597千元(美金141千元)；優方經核准之金額係核准第三地區之盈餘轉增資金額計4,627千元(美金143千元)，惟分別於民國一一二年十二月及一一一年十一月匯回現金股利12,864千元(美金397千元)及8,526千元(美金263千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。本公司之限額計算為淨值3,657,533千元 $\times$ 60%=2,194,520千元；因芯通、優方及倍創符合在大陸地區從事投資或技術合作審查原則規定屬中小企業標準，限額為80,000千元或淨值其較高者。

註5：係依同期間經台灣母公司會計師核閱之財務報告認列投資損益。

### 3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一三年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

## 盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79 %

### 十四、部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報告一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。